

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2020年5月14日(14.05.2020)



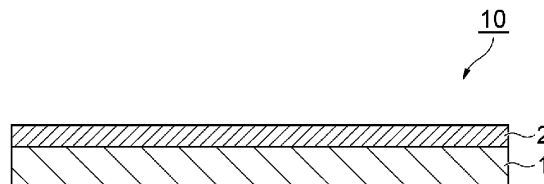
(10) 国際公開番号

WO 2020/096011 A1

- (51) 国際特許分類:
B32B 25/08 (2006.01) *H01L 23/31* (2006.01)
B32B 27/00 (2006.01) *C09J 133/00* (2006.01)
C09J 11/06 (2006.01) *C09J 7/25* (2018.01)
H01L 23/14 (2006.01) *C09J 7/38* (2018.01)
H01L 23/29 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2019/043750
- (22) 国際出願日: 2019年11月7日(07.11.2019)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2018-211552 2018年11月9日(09.11.2018) JP
- (71) 出願人: 日立化成株式会社(HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD.) [JP/JP]; 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 黒田 孝博 (KURODA Takahiro); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 日立化成株式会社内 Tokyo (JP). 名児耶 友宏(NAGOYA Tomohiro); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 日立化成株式会社内 Tokyo (JP). 友利 直己(TOMORI Naoki); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 日立化成株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外(HASEGAWA Yoshiki et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号丸の内 M Y P L A Z A (明治安田生命ビル) 9階 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).

(54) Title: TEMPORARY PROTECTIVE FILM FOR PRODUCING SEMICONDUCTOR DEVICE, REEL BODY, AND METHOD FOR PRODUCING SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称: 半導体装置製造用仮保護フィルム、リール体、及び、半導体装置を製造する方法



(57) Abstract: Disclosed is a temporary protective film for producing a semiconductor device, the temporary protective film being for temporarily protecting a surface of a semiconductor substrate that is opposite a surface where a semiconductor element is mounted. This temporary protective film is provided with an adhesive layer that contains acrylic rubber. When the temporary protective film is affixed to a copper alloy plate at 25 ° C so that the adhesive layer is in contact with the copper alloy plate, and the resulting laminate is heated for 60 minutes at 180 ° C and for 60 minutes at 200 ° C in the stated order, the 90-degree peel strength of the temporary protective film with respect to the copper alloy plate is 5 N/m or higher at 25 ° C before the laminate is heated, and the aforementioned 90-degree peel strength is 150 N/m or higher at 50°C after the laminate is heated.

(57) 要約: 半導体基板の半導体素子が搭載される面とは反対側の面を仮保護するための半導体装置製造用仮保護フィルムが開示される。仮保護フィルムが、アクリルゴムを含有する接着層を備える。仮保護フィルムを、銅合金板に、接着層が銅合金板に接するように25℃で貼り付け、得られた貼合体を180℃で60分間及び200℃で60分間の順で加熱したときに、仮保護フィルムの銅合金板に対する90度ピール強度が、貼合体が加熱される前に25℃において5N/m以上で、貼合体が加熱された後に50℃において150N/m以下である。

[続葉有]

WO 2020/096011 A1

- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 一 国際調査報告(条約第21条(3))